STANDARDLAGENAUFBAU HDI

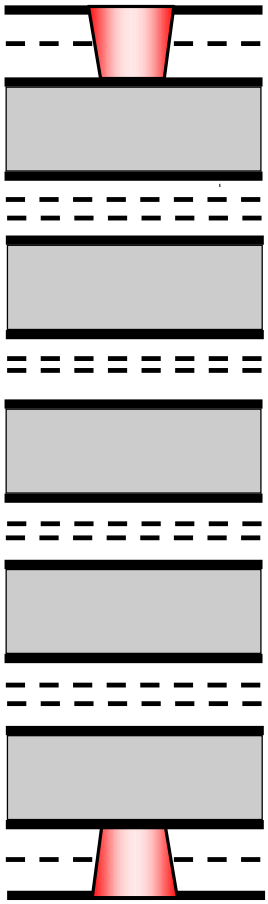
HDI12_1+10+1_1,45_35

12 - Lagen

Kerne: 0,10 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 10 + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	2			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
3	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
4	4			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
5	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
6	6			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
7	7			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
8	8			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
9	9			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
10	10			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
11	11			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1470

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,45**	+/-	0,12	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,54	+/-	0,15	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,60	+/-	0,17	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
28.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00	Seite:	2+